

第22回 有機/無機接合研究委員会

日時：2024年10月21日(月) 13:00~16:00

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室 (東京都中央区)

プログラム

司会 渡辺 潤 (OKI ネクステック(株))

13:00~13:10 委員会議事

13:10~13:50

『大気 UV 処理法による表面改質を施した樹脂上への無電解めっき技術』(40分)

..... ○堀内 義夫、本間 英夫 (関東学院大学)

13:50~14:30

『L 接着継手の引張り、疲労およびクリープ強度の広範囲温度依存性および熱活性による解析的検討』(40分)

..... ○北條 恵司 ((国研)産業技術総合研究所)

14:30~14:40 休憩

司会 福本 信次 (大阪大学)

14:40~15:20

『レーザーによる樹脂-金属の異材接合』(40分)

..... ○三瓶 和久 ((株)タマリ工業)

15:20~16:00

『CFRTP とアルミニウム合金の超音波接合』(40分)

..... ○佐々木 朋裕^{*1}、張 哲源^{*1}、前田 侑斗^{*2}、久守 駿^{*2}

(^{*1}新潟大学、^{*2}三菱自動車工業(株))

() 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会